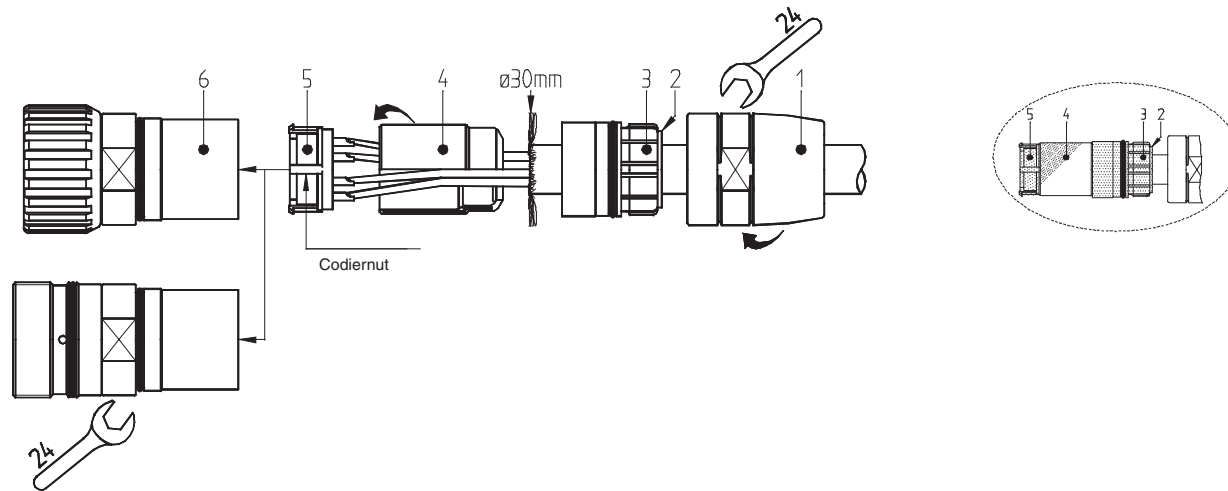


# Signalsteckverbinder – CONINVERS signal

## M27 – Serie HC

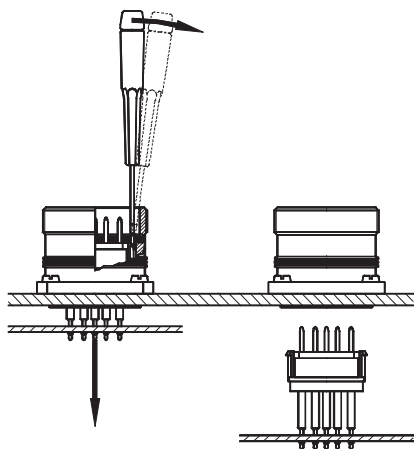
Kabel- und Kupplungssteckverbinder,  
gerade, geschirmt



- Adapter Pos. 1, Dichtelement Pos. 3 mit Dichtring Pos. 2 auf das Kabel schieben.
- Kabel-Außenmantel 30 mm abisolieren.
- Schirmgeflecht 90° hochstellen und auf Maß abschneiden.
- Folie, Füller und innere Isolierungen abschneiden.
- Litzen 3,5 mm abisolieren, verdrillen (und verzinnen).
- Litzen an Kontakte löten, crimpen oder schrauben.
- Distanzhülse Pos. 4 einfügen.
- Einsatz Pos. 5, Distanzhülse Pos. 4 und Dichtelement Pos. 3 mit Dichtring Pos. 2 (s. Ausschnitt) in Einsatzhülse Pos. 6 einführen; hierbei ist zu beachten, daß die gewünschte **Codiernut** des Einsatzes Pos. 5 **in den Codiernut** der Einsatzhülse Pos. 6 eingeführt wird.
- Adapter Pos. 1 Festschrauben **auf Anschlag!**

## Gerätesteckverbinder, gerade

### Entriegeln Kontaktträger



- Einfaches Entriegeln von der Steckseite ohne Spezialwerkzeuge

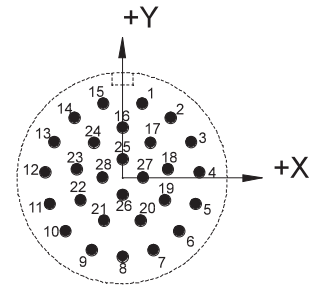
# Signalsteckverbinder – CONINVERS signal

## M27 – Serie HC

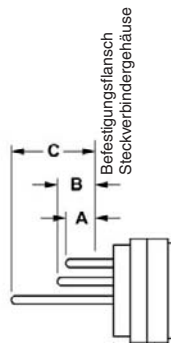
### Leiterplattenlochbild 26-/28-polig für PCB Montage (Einlötkontakte)

#### Mittigkeitsabweichung $\pm 0,1$ mm

	X	Y		X	Y
Pos. 1	+1,95	+7,47	Pos. 15	-1,95	+7,47
Pos. 2	+4,85	+6,05	Pos. 16	-0,82	+5,03
Pos. 3	+6,82	+3,65	Pos. 17	+2,82	+3,64
Pos. 4	+7,72	+0,65	Pos. 18	+4,55	+0,97
Pos. 5	+7,28	-2,53	Pos. 19	+4,28	-2,13
Pos. 6	+5,67	-5,23	Pos. 20	+1,83	-4,17
Pos. 7	+3,08	-7,08	Pos. 21	-1,83	-4,17
Pos. 8	+0,55	-7,73	Pos. 22	-4,25	-2,13
Pos. 9	-3,08	-7,08	Pos. 23	-4,55	+0,97
Pos. 10	-5,67	-5,27	Pos. 24	-2,82	+3,65
Pos. 11	-7,28	-2,53	Pos. 25	-0,82	+1,88
Pos. 12	-7,75	+0,63	Pos. 26	-0,82	-1,63
Pos. 13	-6,82	+3,65	Pos. 27	+2,02	+0,14
Pos. 14	-4,82	+6,05	Pos. 28	-2,02	+0,14



Typ	Freie Lötstiftlänge [mm]		
	A	B	C
Einlöt-Pin-Ø	0,6 mm	1,0 mm	0,8 mm
HC-.....2300	3,5	4,5	10,0
HC-.....WA00	–	–	10,0
HC-.....4300	3,5	4,5	10,0



Die **freie Lötstiftlänge** A, B oder C ist das Maß zwischen dem Befestigungsflansch des Gerätesteckverbinders und dem Ende des Einlötkontaktes. In dieses Maß wird die Gehäusewandstärke und der Luftspalt zur Leiterplatte mit einbezogen.